



DISCO

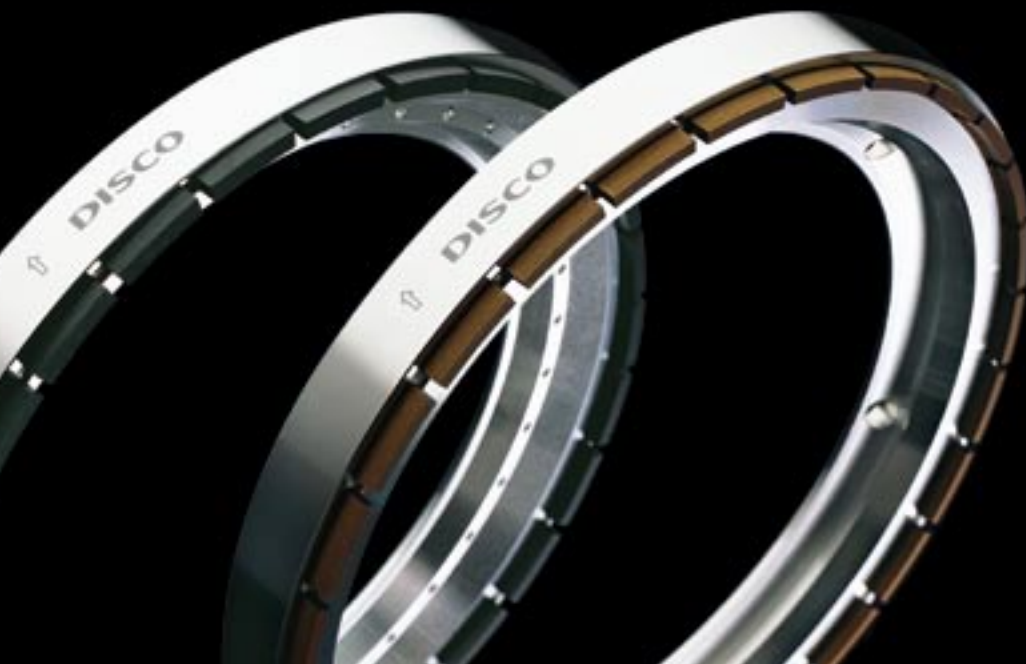
Kiru · Kezuru · Migaku Technologies



Grinding Wheels

GF01 SERIES

新基台の採用によりホイールライフの最適化を実現



より優れた研削性と安定性を提供するGF01シリーズ

インフィード方式のグラインダ向けに新たにラインアップされたGF01シリーズ。ディスコ独自の新基台を採用することにより、従来のIFシリーズと比べて効率良く加工点へ研削水を供給することが可能になりました。効率的な研削水の供給によって、安定した研削性とホイールライフの最適化を実現します。

- 新開発の基台の採用により効率的な研削水の供給を実現
- IFシリーズと同様のボンドを使用可能
- 優れた仕上がり精度と安定した研削力
- 環境に配慮したPP(ポリプロピレン) 製またはABS樹脂製パッケージを採用

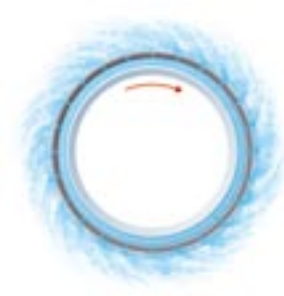


■ 研削水供給状態

現行基台 (IFシリーズ)



新基台 (GF01シリーズ)



加工対象

シリコンウェーハ、化合物半導体ウェーハ、電子部品
向け結晶材料、他

製品ラインアップ

各種ボンドと粒径の組み合わせにより、ウェーハ裏面の膜・薄残し研削の安定した加工を実現します。

■粗研削用

ウェーハ裏面の酸化膜、窒化膜などの影響を受けにくい、安定した加工を実現します。

VS : 標準タイプ BT300 : 加工品質とライフを両立したタイプ
BT100 : 薄残し研削に適したタイプ

■仕上げ研削用

ワークへの加工ダメージが少ないレジジンボンドの採用により、安定した研削が可能です。厚さ精度(TTV)・面粗さを向上させ、品質の向上とロングライフを両立させます。

BK01 : 研削性を重視したタイプ BK04 : 標準タイプ
BK02 : 耐摩耗性を重視したタイプ BK09 : 重研削に適したタイプ



仕様

砥粒種類	(mm) ホイール径	特殊仕様	チップ表記	チップ形状	チップ配列
			SD 人造ダイヤ	200	ST
SDC コーティングダイヤ	300		SR	セグメント	真円
			WS	特殊	特殊

GF01-SD 360-VS-100 - A**** 200×4W×4T-ST

粒径	ボンド	集中度	チップ幅	チップ高さ
320 #320	VS	100	4.0	4.0
360 #360	BT100	50	4.0	5.0
400 #400	BT300	50	4.0	5.0
600 #600	BK01	200	4.0	5.0
800 #800	BK02	100	4.0	5.0
1000 #1000	BK04	100	2.0	5.0
1200 #1200	BK09	100	3.0	5.0
1400 #1400				
1500 #1500				
1700 #1700				
2000 #2000				
3000 #3000				
4000 #4000				

ボンド別チップ寸法 (mm)

上記は標準寸法です。アプリケーションや組み合わせにより適用が異なる場合があります。

標準対応範囲*1

用途	ボンド名	粒径								
		#320	#360	#1200	#1400	#1500	#1700	#2000	#3000	#4000
粗研削用 (Z1軸用)	VS									
	BT100									
	BT300									
仕上げ研削用 (Z2軸用)	BK01									
	BK02									
	BK04									
	BK09									

*1 標準対応範囲はタイプにより異なりますので、詳しくは弊社営業担当にお問い合わせください。

ホイールの選定にあたって

加工結果は、粗研削用ホイールと仕上げ研削用ホイールの組み合わせにより大きく異なります。

このため、ご使用頂くホイールの組み合わせについては、お客様のワークや要求精度などに合わせてご提案させていただきます。

弊社製品は全て製造物賠償責任保険がついております。

ご注文に際して

タイプ名・ホイール径及び数量をお知らせください。また、新規ご注文の場合は弊社営業担当が選定のお手伝いをさせていただきます。研削材料・寸法・形状・使用機械(装置)その他諸条件を詳しくお知らせください。

・仕様は改良のため、お断りなく変更させていただくことがありますのでご確認の上、ご発注くださいますようお願い申し上げます。

▲安全にご使用いただくために

砥石(といし)の破損による事故やケガを未然に防止するために以下の事項を必ずお守りください。

- 安全カバー(ノズルケース、カバー)を使用してください。
- 指定回転数表示のある砥石(といし)は指定の回転数を超過して使用しないでください。
- 砥石(といし)を装着する際は機械(装置)の取扱説明書に従って正しく装着してください。
- 砥石(といし)を落としたり、ぶつたりしないでください。
- 使用する際には必ず毎回砥石(といし)を確認して、欠けやその他破損がある場合は使用を中止してください。
- ご使用の機械(装置)の取扱説明書をよく読んでからご使用ください。
- 改造された機械(装置)は使用しないでください。
- 機械(装置)指定サイズに合わない砥石(といし)は使用しないでください。
- 切断・研削以外の目的には使用しないでください。
- 湿式切断の砥石(といし)は冷却液をご使用ください。



株式会社 ディスコ

143-8580 東京都大田区大森北 2-13-11

Phone:03-4590-1000(営業代表) Fax:03-4590-1001 www.disco.co.jp